

证券代码：688693

证券简称：锆威特

苏州锆威特半导体股份有限公司
投资者关系活动记录表
(2024年半年度业绩说明会)

编号：2024-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2024年半年度业绩说明会的投资者
时间	2024年09月27日 15:00-16:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 丁国华 董事、总经理 罗寅 独立董事 秦舒 董事会秘书 严泓 财务总监 刘娟娟
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1.目前主要客户群体有哪些？公司是否有计划拓展新的客户群体或市场，以减少对单一市场的依赖？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好！目前公司的客户群体主要包括高可靠领域电源龙头企业及国家重点科研院所，以及工业控制领域的客户，如工业储能、光伏逆变、新能源汽车及充电桩、工业电源等细分应用领域。公司将在原有客户基础上拓展新的客户群体或市场，积极开展相关产品业务的客户开发、渠道建设、市场开拓等工作,以实现客户基础的多元化。感谢您对公司的关注。</p> <p>2.公司在功率半导体市场中的定位是什么？公司采取了哪些策略来保持或提升市场份额？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好！公司专注于功率半导体的设计、研发与销售，坚持“自主创芯，助力核心芯片国产化”的发展定位，立</p>

志将公司打造成高品质功率半导体供应商。公司采取的策略包括优化拓展细分产品领域，扩大在高可靠领域和工业控制领域的销售规模，提升总体收入规模和市场占有率。感谢您对公司的关注。

3.如何管理供应链以确保原材料的稳定供应和成本控制？在当前全球供应链紧张的背景下，公司有何应对措施？

答:尊敬的投资者，您好！公司已与国内知名晶圆制造厂商及封测厂商建立了长期合作关系，形成了稳定的供应渠道，并具有完善的外协供应商管理体系，对主要供应商进行有效管理，以保证产品质量和供应稳定性。公司将继续加强与供应商的合作，优化供应链管理，以确保原材料的稳定供应和成本控制。感谢您对公司的关注。

4.鉴于公司产品在多个领域如工业控制、新能源等领域的应用，公司如何确保产品开发与市场需求保持同步？公司如何收集和分析市场数据来指导产品开发？

答:尊敬的投资者，您好！公司通过制定系统的研发管理制度和版图设计流程规范，对研发过程中的各个环节进行规范，保证设计研发产出符合公司要求规定，从而提升研发产出效率和成功率。同时，公司建立了市场调研队伍，深入了解客户未来需求，以争取到更多的项目机会。此外，公司实时关注国外先进厂商的技术发展动态，不断对照差距，进行前沿技术的研发与探索。感谢您对公司的关注。

5.面对激烈的市场竞争和行业变化，公司在报告期内是否有进行战略调整？

答:尊敬的投资者，您好！公司所做调整主要包括产品线优化丰富、市场定位调整以及新的业务领域拓展。公司持续注重研发创新，强化核心竞争力，针对功率器件和功率 IC 产品线进行了优化，加大了 SiC MOSFET 产品的研发投入，并积极开拓新的客户和市场。感谢您对公司的关注。

6.公司在保护其研发成果和知识产权方面采取了哪些措施？目前拥有的专利数量和类型能否满足当前和未来市场竞争的需求？

答:尊敬的投资者，您好！公司在保护其研发成果和知识产权方面采取了以下措施：制定了相关保密制度，明确员工保密、竞业限制等内容；通过与员工签订保密协议、竞业协议和开展宣传培训等，从制度和意识加强对知识产权的认识和保障；建立了《信息系统、信息设备和存储设备管理制度》等内部管理制度，对员工上网行为、涉密设备、系统软件、公司网络等各方面进行了全面规定。截至 2024 年 06 月 30 日，公司累计共已获授权专利 109 项（其中发明专利 66 项、实用新型专利 43 项），集成电路布图设计专有权 87 项。现有的专利数量和类型能够满足当前和未来市场竞争的需求，并将继续加大研发投入，保持技术优势。感谢您对公司的关注。

7.请问领导们对未来市场趋势有何预测？公司的战略规划如何与

这些市场趋势相适应？

答:尊敬的投资者，您好！半导体产业整体复苏周期长于预期，回暖速度呈现明显分化。受数字经济、AI 及新质生产力发展的推动，与数字芯片相关的晶圆代工及封测已呈恢复态势，但功率及模拟类仍不达预期，短期看价格未出现全面上涨信号。同时，客户对供应商的要求将更为全面，不仅关注产品本身的性能，还更重视供应商的服务能力、可持续发展能力以及是否具备完善的经营体系等其他方面的综合实力。这种变化预示着供应商需要提供更加全面和高质量的服务，以满足客户日益增长的多元化需求。公司通过持续加强市场推广，完善营销体系，优化供应链管理以适应市场的不断变化。感谢您对公司的关注。

8.人力资源管理方面有哪些策略？公司如何吸引和保留关键人才？

答:尊敬的投资者，您好！公司始终坚持科技创新，顺应市场发展趋势，注重强化自主研发能力建设。公司根据业务发展及人才储备需要，制定人才招聘计划，并持续优化公司的运行机制和管理规范，提升人力资源管理水平和管理效率，为员工营造良好的氛围，保证公司长期稳定的发展。感谢您对公司的关注。

9.上半年公司有哪些关键项目取得了显著进展？这些项目对公司未来发展有何影响？

答:尊敬的投资者，您好！在过去的半年中，公司持续加大研发投入，根据市场发展趋势、下游客户需求，不断拓宽产品系列。PWM 控制 IC 方面：公司持续丰富产品线，完成了反激、正激、半桥、推挽、全桥、移相全桥等隔离拓扑产品系列化，推出了输入电压高达 100V 以上同步 Buck 控制器、同步 Boost 控制器等新品。为提高电源系统效率，推出了可支持反激、QR、LLC 等拓扑的同步整流驱动 IC，工作频率可高达 1MHz，工作电压可达 300V。功率驱动 IC 方面：公司推出 80V3A 集成 MOSFET 的单芯片 H 桥驱动芯片，同时可支持 100% 占空比工作中，进一步提升系统的安全及可靠性；公司推出 180VGaN 专用半桥驱动芯片，工作频率高达 1MHz 以上。在功率 MOSFET 方面，报告期内公司开发完善了沟槽 MOSFET 及高压超结的工艺平台优化和产品布局，开发了 100VSGT 工艺平台及 12 寸 20V-40V 的沟槽工艺平台，完成了 650V100A 大电流的超结产品开发。SiC MOSFET 方面：公司加大 SiC MOSFET 加工的产能布局及工艺平台的开发，报告期内与国内晶圆代工厂合作开发了 1200V、1700V、2600V、3300V SiC MOSFET 的生产工艺平台，其中 1200V SiC MOSFET 工艺平台已成功进入中试阶段。上述技术成果或产品创新都将对公司未来发展有着积极的影响。感谢您对公司的关注。

附件清单（如有）	
日期	2024年09月27日